(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/104520 A1

(51) 国際特許分類?: C23C 14/12, 14/24, H05B 33/10, 33/14

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07117

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-166522 2002 年6 月7 日 (07.06.2002) JF

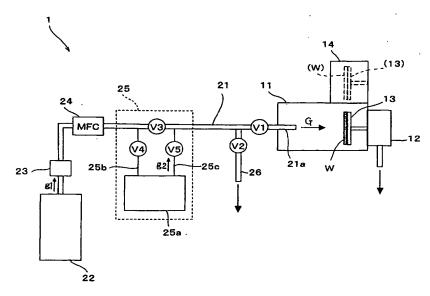
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001東京都品川区 北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 簗嶋 克典 (YANASHIMA,Katsunori) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 成井 啓修 (NARUI,Hironobu) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 目々澤 聡彦 (MEMEZAWA,Akihiko) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 佐々木 浩司 (SASAKI,Koji) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA,Tomoyuki); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ ル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).

[毓葉有]

(54) Title: METHOD FOR FORMING ORGANIC THIN FILM

(54) 発明の名称: 有機薄膜の形成方法



(57) Abstract: A method for forming an organic thin film of uniform quality in a substrate surface without heating the film forming surface. A gas (film forming component gas) (g2) is produced by vaporizing a single film-forming component of an organic material and transported and supplied into a processing chamber (11) where a substrate (W) is placed. The organic material holding the film-forming component is deposited on the substrate (W) in the processing chamber (11) to form an organic thin film. During the deposition of the organic material, the substrate (W) is kept cooled. The film-forming component gas (g2) is transported and supplied into the processing chamber (11) by a carrier gas such as an inert gas (g1). By repeating such deposition of an organic material, a multilayer of organic thin films of different film-forming materials is formed.

(57) 要約: 成膜面において発熱することなく、かつ基板面内に均一な膜質の有機薄膜を形成することが可能な有機薄膜の形成方法を提供する。有機材料からなる単一の成膜成分を気化させたガス(成膜成分ガス)(g2)を発生させ、基板(W)が収納された処理室(11)内に成膜成分ガス(g2)を輸送供給する。そして、処理室(11)内の基板(W)表面に、



(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

有機薄膜の形成方法

5

技術分野

本発明は、有機薄膜の形成方法に関し、特には有機EL素子のような 光学素子を構成する有機薄膜の形成に好適に用いられる有機薄膜の形成 方法に関する。

10

15

背景技術

有機材料のエレクトロルミネッセンス(electroluminescence:以下ELと記す)を利用した有機EL素子は、陽極と陰極との間に有機層を挟持してなる。このような構成の有機EL素子においては、有機層の材料選択によって各色に発光する発光素子を得ることが可能であり、各色に発光する発光素子を所定状態で配列形成することによって、マルチカラー表示またはフルカラー表示が可能な表示装置を構成することが可能である。

ところで、このような有機EL素子の製造においては、真空蒸着法に 20 よる有機層の形成が行われている。真空蒸着法は、蒸発源の上方に当該 蒸発源に対して基板を対向させて配置した状態で、当該蒸発源から蒸着 材料を蒸発させることで、当該基板の表面に蒸着材料を供給し堆積させ る方法である。このような、真空蒸着法による成膜において成膜速度を 制御するには、蒸発源の温度を変化させるなどして、蒸着材料の蒸発レ ートを変化しなければならない。しかし、温度と蒸発レートとはリニア に対応しておらず、また、温度を変化させることで蒸発レートが不安定

20

な挙動を示すため、正確な制御を困難である。また、温度変化に対する 蒸発レートの応答性も悪いため長いプロセス時間が必要になり、生産性 が悪いといった問題もある。

そこで、このような真空蒸着法にかわる成膜方法として、有機気相堆 積法(organic vapor phase deposition: OVPD法)が提案されている(特表2001-523768公報および特表2000-50429 8号公報)。これらの公報に開示されているように、OVPD法は、基板が収納された反応器内に複数の有機前駆物質を気相で供給してこれらの有機前駆物質を反応させ、反応によって生じた有機化合物を基板の表面に積層させて有機薄膜を形成する方法である。この際、有機前駆物質の反応は、化学反応または複数の有機前駆物質の混合であり、また有機前駆物質同士は供与体・受容体の関係であるか、ゲスト・ホストの関係であっても良い。

このようなOVPD法においては、反応器内への有機前駆物質の供給 15 速度によって成膜速度が調整されるため、真空蒸着法と比較して成膜速 度の制御性が良好で成膜速度も速い。

ところが、OVPD法による有機薄膜の形成には、次のような課題があった。すなわち、OVPD法においては、反応器内に複数種類の有機前駆物質を供給し、反応器内においてこれらを反応(化学反応または混合)させているため、反応器内における有機前駆物質の混合状態が不均一であったり、また混合状態が均一であっても反応器内における温度分布のばらつきがある場合には反応(化学反応)が不均一になる。これにより、基板面内に形成される有機薄膜の膜質にばらつきが生じやすい。

さらに、有機前駆物質の反応によって反応熱が発生する場合もあり、 25 基板上に既に形成されている有機薄膜が反応熱の影響によって劣化する。 したがって、上述したような複数の有機膜を積層することで発光層を含 む有機層を形成する有機EL素子の製造にOVPD法を適用した場合には、上述した反応熱の影響によって下層の有機膜が劣化し、良好な素子特性を得ることが困難であった。

そこで本発明は、成膜面において発熱することなく、かつ基板面内に 5 均一な膜質の有機薄膜を形成することが可能な有機薄膜の形成方法を提 供することを目的とする。

発明の開示

15

このような目的を達成するための本発明の有機薄膜の形成方法は、有 10 機材料からなる単一の成膜成分を気化させたガスを発生させ、このガス を基板が収納された処理室内に輸送供給し、この処理室内の基板表面に 成膜成分を保った有機材料を堆積させる方法である。

このような有機薄膜の形成方法では、処理室内に輸送供給された有機 材料からなる単一の成膜成分のみが、その成膜成分を保って基板表面に 堆積される。このため、基板表面においては、成膜成分の混合の不均一 性が生じたり、また成膜成分同士の反応による反応熱が生じることはな い。

図面の簡単な説明

20 図1は本発明の有機薄膜の形成方法を行うための成膜装置の構成図である。

図2は本発明を適用して製造される有機EL素子の構成例を示す断面図である。

図3は本発明を適用して得られる有機EL素子の発光層の層構造の 25 第1例を示す断面図である。

図4は本発明を適用して得られる有機EL素子の発光層の層構造の

第2例を示す断面図である。

図5は本発明を適用して得られる有機EL素子の発光層の層構造の 第3例を示す断面図である。

5 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の有機薄膜の形成方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

<成膜装置>

15

20

25

図1は実施形態の有機薄膜の形成に用いる成膜装置の一例を示す概略 10 図である。この図に示す成膜装置1は、有機薄膜の形成処理が施される 基板Wを収納するための処理室11を備えている。

この処理室11には、排気システム12が備えられており、内部が所定の圧力にコントロールされる。ここでの図示は省略したが、排気システム12によって排気されるガスは、トラップを通り余分な材料を捕獲し、後で説明する不活性ガス(例えば N_2)のみが、装置外に排出される構成となっており、この排気はスクラバーを通過後に大気開放される構成となっている。

そして、この処理室11内には基板Wを支持するための基板支持台1 3が収納され、基板支持台13に支持された状態の基板Wの温度制御が 自在な温度制御機構を備えると共に、保持された基板Wをその面内にお いて回転またはスライドさせる駆動機構を備えていても良い。

また、この処理室11には、基板支持台13に基板Wを固定させる作業を行うためのロードロック室14が設けられている。このロードロック室14は、内部をポンプで排気でき、また不活性ガス等で自在に置換出来る構成となっており、不活性ガス雰囲気内において基板支持台13に基板Wを固定させ、ポンプで排気し、減圧にした状態でロードロック

20

室1.4 - 処理室11間のゲートバルブ(図示省略)を開くことにより、 基板Wを固定させた基板支持台13を処理室11内に所定状態で配置収 納することが可能である。

また、処理室11には、処理室11内にガスGを供給する供給管ライン21が接続されている。この供給管ライン21の先端であるガス導入口21aは、処理室11内に挿入され、処理室11内に所定状態で配置収納された基板支持台13の基板保持面に向けて、ガスGを吹き出すように設定されている。

一方、供給管ライン21の他端は、キャリアガスとなる高純度の不活 性ガス (例えば N_2 、He、Ar) または水素などのガス精製装置22 (またはボンベ) に接続されている。そして、ガス精製装置22から処理室 1 1 までの間の供給管ライン21には、ガス精製装置22側から順に、圧力調整機23、マスフローコントローラ (MFC) 2 4、および原料供給機構25が設けられ、さらにベントライン26が接続されると共に、 ベントライン26と処理室11との間にバルブV1が設けられた構成になっている。また、ベントライン26にも、バルブV2が設けられていることとする。

このうち、原料供給機構25は、有機薄膜の原料となる有機材料が貯蔵された原料容器25a、供給管ライン21から分岐して原料容器25aに挿入される導入管25b、この導入管25bよりも下流側の供給ライン21から分岐して原料容器25aに挿入された排出管25cを備えている。そして、供給管ライン21における導入管25bと排出管25cとの分岐の間、導入管25b、および排出管25cには、それぞれバルブV3, V4, V5が設けられている。

25 以上のような構成の成膜装置1において、マスフローコントローラ 2 4 ~ 処理室 1 1 までの配管、容器等はすべて、所定の高温に温度制御さ

() ¢

れることとする。温度制御のための加熱方式は、オーブン内などに設置する空気恒温槽方式でも、高温オイルなどを循環させる方式でも、RF加熱(Radio Frequency加熱:高周波誘導加熱)方式でも、ランプ加熱方式でも良く、特に限定されることは無い。

5 <有機薄膜の形成方法>

次に、以上のような構成の成膜装置1を用いた有機薄膜の形成方法を説明する。ここでは、一例として、有機EL素子に一般的に用いられるAlq3[tris(8-quinolinolato)aluminu(III)]からなる電子輸送性発光層を形成する場合の実施の形態を説明する。

- 10 まず、ロードロック室14内において基板支持台13に基板Wを保持 固定し、ロードロック室14内を減圧にした後、それぞれほぼ同じ圧力 に保たれたロードロック室14と処理室11との間のゲートを開けて、 基板支持台13を処理室11内の所定位置にセットする。この際、ロー ドロック室14内と処理室11内とは、例えば133Paに保つ。そし て、基板支持台13の温度制御機構によって基板Wを20℃程度に保持 する。また、基板支持台13に回転またはスライド機構が備えられてい る場合、この機構によって基板Wを回転させておくこととし、これによ り膜厚の均一な成膜が行われるようにする。
- 一方、原料供給機構25の原料容器25 aには、有機薄膜の原料とな 20 る有機材料 (ここではA1q3) を貯蔵すると共に、原料容器25 a内 の有機材料を所定温度 (A1q3の場合には280℃) に加熱する。こ れにより、原料容器25 a内に、加熱温度に対する有機材料 (A1q3) の蒸気圧分を気体として存在させておく。また、マスフローコントロー ラ24~処理室11までの配管、容器等はすべて、所定の高温に温度制 25 御 (例えば280℃程度) に加熱しておくこととする。

以上のような状態で、バルブV2、V3を閉じ、バルブV1、V4、

V5を開く。そして、高純度ガス精製装置22から、圧力調整機23により、例えば0.2MPaに圧力コントロールされ、マスフローコントローラ24により高精度に流量コントロールされた不活性ガス(例えば N_2)g1を、供給管ライン21に流す。流量の一例としては、1000 s c c m(standard cc /min:標準状態での1分あたりの流量)である。そして、不活性ガスg1を原料容器25aに供給し、原料容器25a内において気化された有機材料(Al q 3)のガスを、成膜成分ガスg2とし、不活性ガスg1をキャリアガスとして排出管25cおよび供給管ライン21から処理室11内に輸送供給する。

- 10 これにより、処理室11内の基板支持台13に固定保持された基板Wに向けて、ガス導入口21aから成膜成分ガスg2として有機材料(Alq3)ガスを含むガスGが供給される。そして、20℃の温度に保たれた基板Wの表面に有機材料(Alq3)がその成分を保った状態で堆積され、Alq3からなる有機薄膜が形成される。
- 15 この際、有機薄膜の膜厚は、処理室11内へのガスの供給時間によって制御され、所定膜厚の有機薄膜が形成されたところで、バルブV1, V4, V5を閉じ、バルブV2, V3を開き、処理室11内への成膜成分ガスg2の供給を停止すると共に、処理室11内を不活性ガスg1で置換する。
- 20 以上の後、基板Wおよび基板支持台13をロードロック室14に戻し、ロードロック室14内の圧力を常圧に戻して基板Wを取出す。このとき、有機薄膜が形成された基板Wが大気に触れないように、ロードロック室14内において基板Wを専用の N_2 ガス封止箱に移載し、 N_2 ガス封止箱を成膜装置1の外へ持ち出すようにしても良い。
- 25 以上の有機薄膜の形成方法においては、有機材料からなる単一の成膜 成分ガスg2のみが不活性ガスと共に処理室11内に輸送供給され、処

10

20

25

理室11内に収納された基板W表面には、有機材料がその成膜成分を保って基板W表面に堆積される。このため、基板W表面においては、成膜成分の混合の不均一性が生じたり、また成膜成分同士の反応による反応熱が生じることはない。したがって、反応熱による下層有機膜の劣化を引き起こすことなく、かつ基板W面内において膜質が均一な有機薄膜を形成することが可能になる。

尚、上述した有機薄膜の形成方法においては、基板Wの表面に単層膜(Alq3)を形成する場合を説明したが、この基板W上に複数の有機薄膜を積層形成する場合には、処理室11とガス精製装置22(または圧力調整機23)との間に、マスフローコントローラ24~バルブV1までの部分を設けた複数の供給ライン21を設けて成膜装置を用いる。このような成膜装置を用いることで、異なる有機材料からなる成膜成分ガスを、順次、複数の供給ライン21から処理室11内に導入し、複数の有機薄膜を連続的に積層形成することが可能になる。

15 次に、このような複数の有機薄膜の連続成膜の例として、有機EL素 子の製造に本発明の有機薄膜の形成方法を適用した実施の形態を説明す る。

図2は、有機EL素子の構成の一例を示す断面図である。有機EL素子100は、ガラスなどからなる基板W上に、第1電極101、有機層102、および第2電極103がこの順で積層された構成になっている。第1電極101は陽極(または陰極)として用いられ、第2電極103は陰極(または陽極)として第1電極101と対で用いられる。

有機層102は、陽極側(ここでは例えば第1電極101側)から陰極側(ここでは例えば第2電極103側)に向かって順に、正孔注入層102a、正孔輸送層102b、発光層102c、電子輸送層102d、さらには電子注入層102e等の有機薄膜を積層してなる。これらの各

15

20

25

層(有機薄膜層) 1 0 2 a ~ 1 0 2 e は、発光素子 5 の発光色毎に異なる材料を用いてパターン形成されている。尚、有機層 1 0 2 は、このような層構造に限定されることはなく、少なくとも発光層を有する構成であれば、必要に応じた積層構造を選択することができる。

5 また、基板W上に形成された有機EL素子100は、ここでの図示を 省略した保護膜、封止剤などによって封止されている。

このような構成の有機EL素子100の製造においては、有機層10 2を構成する各有機薄膜層102a~102eの形成に、上述した有機 薄膜の形成方法が適用される。この際、図1を用いて説明した成膜装置 1において、複数の供給ラインを設けた成膜装置を用いることで、各有 機薄膜層102a~102eを連続的に形成することができる。

特に、各有機薄膜層102a~102eが、ホストとなる有機材料にドーパントとして他の有機材料を添加した構成である場合には、ホスト層とドーパント層とを連続的に形成することで、デルタドーピング的にホスト材料中にドーパントが添加された各有機薄膜層102a~102eを積層形成することができる。

この場合、ホスト層とドーパント層とは、それぞれ上述したように下層に熱的な影響を及ぼすことなく、かつ膜質が均一に形成されるため、ホスト層とドーパント層との膜厚を調整することで、ドーパント濃度が基板面内で高精度に調整され、制御性に優れた各有機薄膜層102a~102eを形成することが可能である。

また、ホスト層とドーパント層との膜厚を調整することで、ドーパント濃度が基板面内で高精度に調整されるため、各有機薄膜層 1 0 2 a ~ 1 0 2 e の設計の自由度(すなわち有機 E L 素子の設計の自由度)を得ることができる。

例えば、図3に示すように、所定膜厚のホスト層Aを上下層の界面に

25

接して設け、これらのホスト層A間にドーパント層Bを形成することで、ホストの中央部のみにドーパントを添加した有機薄膜層(例えば発光層 102c)を形成することが可能であり、これによりドーパントが近すぎるために起こる濃度消光を回避することができる。

5 また、発光層 1 0 2 c における発光部をドーパント層の位置で制御できるため、自発光による素子の劣化も抑えることが出来る。

また、図4の様に、ホスト層A間におけるドーパント層Bの膜厚を変化させることで、下層との界面に近い位置のドーパント量を少なく、上層との界面に近い位置のドーパント量を多くしたり、その逆にしたりと設計の自由度が増す。

さらに、図5の様にホスト層A間におけるドーパント層Bの膜厚は一定であるが、ホスト層Aの厚さを制御することで、実効的なドーパント 濃度を制御できる。このことは、図4の場合と同様、有機EL素子を作 製する場合の、設計の自由度を増加させることが出来る。

15 尚、各有機薄膜層102a~102eは、基板W上の各画素にパターン形成される。このため、上記成膜装置を用いた各有機薄膜層102a~102eの連続成膜においては、基板Wの成膜表面に対向させて画素毎に開口部を有するマスクを配置し、このマスクの開口部を介して、ガス導入口21aから処理室11内に導入したガスGを基板Wの表面に供20 給することになる。

この場合、上述した有機薄膜の形成方法であれば、真空蒸着法とは異なり、成膜成分ガスの供給方向が自在であるため、基板の成膜表面を下方に向ける必要がない。したがって基板の成膜表面(およびマスク)を略垂直に配置して有機薄膜の形成を行うことが可能であり、成膜表面に対向させて配置されるマスクの撓みを防止することができる。

また、図1を用いて説明した成膜装置1においては、ガス導入口21

a を複数設け、基板Wの成膜表面に対して均等に配置する等の構成とすることで、基板W面の各部に対して同一方向からガスGを供給することができる。このため、真空蒸着法においては、マスクを用いた場合のシャドウ効果により有機薄膜パターンの形成精度にばらつきが生じていたが、このような課題を解決することもできる。また、このような成膜装置の構成であれば、基板W表面に対して均一な膜厚での成膜を行うために、基板支持台13をスライドまたは回転させる必要はなく、装置構成を小型化することができる。

10 産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明の有機薄膜の形成方法によれば、処理室内に有機材料からなる単一の成膜成分ガスのみ供給し、その成膜成分を保って基板表面に有機材料を堆積させる構成としたことで、成膜成分の混合の不均一性が生じたり、また成膜成分同士の反応による反応熱が生じることなく有機薄膜の形成を行うことが可能になる。したがって、反応熱による下層有機膜の劣化を引き起こすことなく、かつ膜質が均一な有機薄膜を形成することが可能になる。この結果、この有機薄膜の形成方法を適用して有機EL素子のような光学素子を形成した場合、特性の良好な素子を得ることが可能になる。

15

5

請求の範囲

- 1. 有機材料からなる単一の成膜成分を気化させたガスを発生させ、 基板が収納された処理室内に前記ガスを輸送供給し、
- 5 前記処理室内の基板表面に前記成膜成分を保った有機材料を堆積させ る
 - ことを特徴とする有機薄膜の形成方法。
 - 2. 請求項1記載の有機薄膜の形成方法において、 前記有機材料を堆積させる際、前記基板を冷却する
- 10 ことを特徴とする有機薄膜の形成方法。
 - 3. 請求項1記載の有機薄膜の形成方法において、

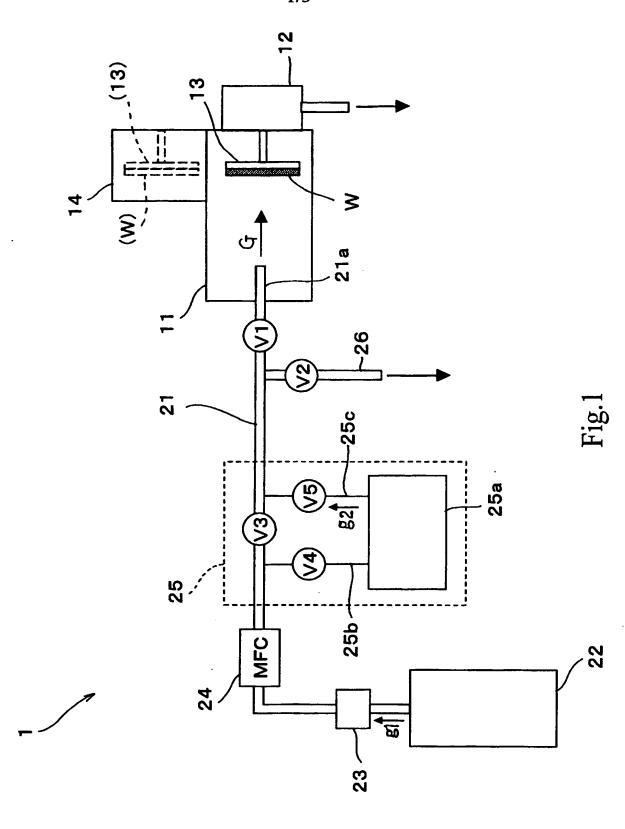
前記有機材料の堆積を繰り返し行うことにより異なる成膜成分を積層する

ことを特徴とする有機薄膜の形成方法。

15 4. 請求項1記載の有機薄膜の形成方法において、

前記ガスは、キャリアガスを利用して前記処理室内に輸送供給されることを特徴とする有機薄膜の形成方法。





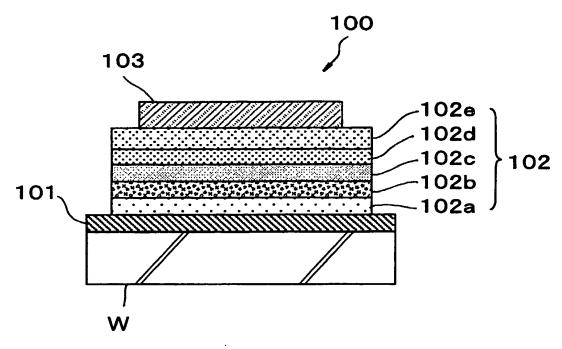
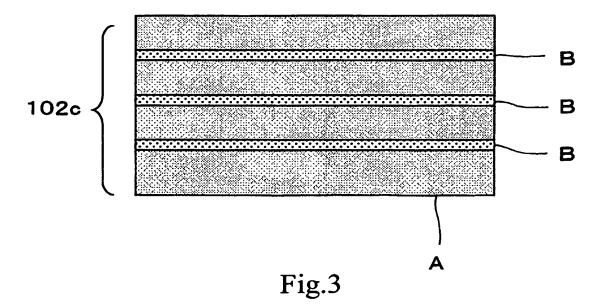
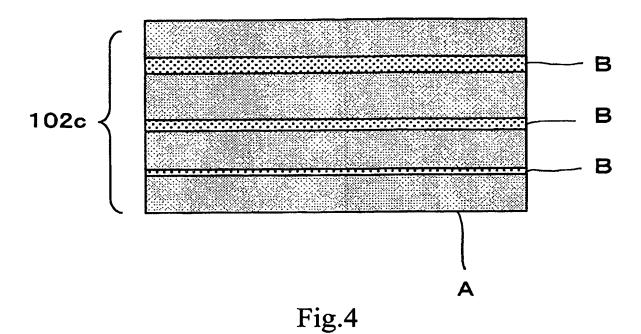


Fig.2





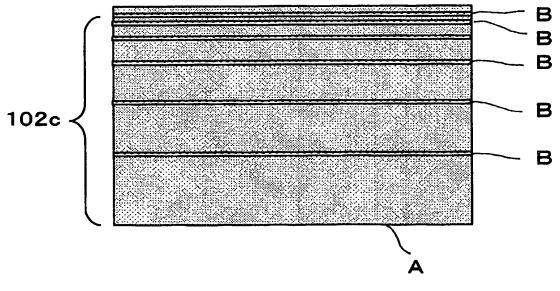


Fig.5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C23C14/12, 14/24, H05B33/10, 33/14					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELD	S SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C23C14/00-14/58, C23C16/00-16/56, H05B33/10, 33/14					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WPI/L[IC=C23C-014/12 and H05B-033/10], JOIS[UKIUSUMAKU and Alq3]					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	US 2001/0010835 A1 (Makoto A 02 August, 2001 (02.08.01), Par. Nos. [0001], [0065]; Fig & JP 9-143700 A Par. Nos. [0001], [0017]; Fig	j. 2	1-4		
Y	JP 2001-313180 A (Samsung SD 09 November, 2001 (09.11.01), Par. Nos. [0001], [0092] (Family: none)		1-4		
Y	US 5444811 A (Fujitsu Ltd.), 22 August, 1995 (22.08.95), Column 8, lines 26 to 27; col & EP 506368 A2 & JP Par. Nos. [0012], [0017]	lumn 10, lines 7 to 9	2		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an invention cannot considered to involve an invention considered to involve			ne application but cited to erlying the invention claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be by when the document is documents, such a skilled in the art family		
Date of the actual completion of the international search 09 September, 2003 (09.09.03) Date of mailing of the international search report 24 September, 2003 (24.09.03)					
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			



Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP 2002-117973 A (Toyota Central Research And Development Laboratories, Inc.), 19 April, 2002 (19.04.02), Par. No. [0071] (Family: none)	1-4
Α	Edited by The Surface Finishing Society of Japan, "Hyomen Gijutsu Binran", The Nikkan Kogyo Shinbun, Ltd., 27 February, 1998 (27.02.98), Pages 825 to 826	1-4
A	The Japan Society of Applied Physics, Edited by Thin Film and Surface Physics Division, "Usumaku Sakusei Handbook", Kyoritsu Shuppan Co., Ltd., 25 March, 1991 (25.03.91), page 179	1-4
	·	



			
C (続き). 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
<i>M</i> , 29 - 4	1995.08.22,第8欄第26-27行,第10欄第7-9 行&EP 506368 A2& JP 4-296729 A,段落番号12,17	明3447年3月47日	
Y	JP 2002-117973 A (株式会社豊田中央研究所) 2002.04.19,段落番号71 (ファミリーなし)	1-4	
A	表面技術協会編,表面技術便覧,日刊工業新聞社,1998,02 27,p.825-826	1-4	
A	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会編, 薄膜作製ハンドブック, 共立出版, 1991, 03. 25, p. 179	1 – 4	